公司代码:688361 公司简称:中科飞测

深圳中科飞测科技股份有限公司

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第二届董事会第四次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：截至2023年12月31日，公司总股本为320,000,000股，以总股本为基准，拟每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利44,800,000元（含税），本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的31.92%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中科飞测	688361	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	古凯男	无
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园1301号	无
电话	0755-26418302	无
电子信箱	IR@skyverse.cn	无

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务概述

报告期内，公司专注于高端半导体质量控制领域，为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。

在设备产品方面，公司通过在光学检测技术、大数据检测算法和自动化软件领域的自主研发和不断创新，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平，形成了集成电路制造过程中所有关键工艺环节所需的主要种类设备产品组合，使得公司能够为不同类型的集成电路客户提供全面覆盖的检测和量测设备供应保障，支持客户的量产工艺需求和未来工艺研发需求；

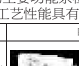
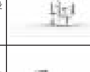
在智能软件产品方面，公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果。

2、公司主要产品情况

报告期内，公司专注于高端半导体质量控制领域，主要产品涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。

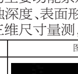
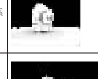
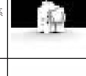
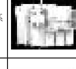
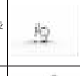
（1）检测设备

公司检测设备的主要功能系检测晶圆表面或电路结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等对芯片工艺性能具有不良影响的特征性结构缺陷，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
无图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于硅片的出厂品质管控、晶圆的入厂质量控制、半导体制程工艺和设备的污染监控。该系列的设备能够实现无图形晶圆表面的缺陷计数，识别缺陷的类型和空间分布。
图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于晶圆表面亚微米量级的二维、三维图形缺陷检测，能够实现在图形电路上的全类型缺陷检测。拥有多模式明/暗照明系统、多种放大倍率镜头，适应不同检测精度需求，能够实现高速自动对焦，可适用于面型变化较大翘曲晶圆。
明场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于晶圆表面多种节点的图形晶圆的明场缺陷检测，拥有多模式照明系统、成像系统，多种放大倍率切换，适应不同检测精度和速度需求，能够实现高速自动对焦，可适用于不同类型晶圆。
暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于复杂图形晶圆表面纳米量级缺陷检测，采用深紫外激光暗场扫描与成像探测技术，实现复杂图形晶圆表面缺陷的快速检测与分类功能。

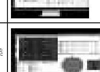
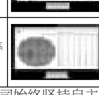
（2）量测设备

公司量测设备的主要功能系对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌、套刻精度等物理性参数的量测。在精密加工领域，量测设备主要功能是精密结构件的三维尺寸量测，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
三维形貌量测设备系列		主要应用于晶圆上纳米级三维形貌测量、线宽测量和TSV孔测量，配合图形晶圆智能化特征识别和流程控制、晶圆传片和数据通讯等自动化平台。
介质膜厚量测设备系列		主要应用于晶圆上纳米级单/多层薄膜、光刻胶等厚度测量，采用椭圆偏振技术和光谱反射技术实现高精度薄膜膜厚、n-k值的快速测量。
金属膜厚量测设备系列		主要应用于晶圆上金属膜厚度和硬掩膜层厚度测量，采用飞秒超声和差分技术，实现高精度膜厚、声速和泊松比的快速测量。
套刻精度量测设备系列		主要应用于电路制作中不同层之间图案对图案对齐的误差测量，并将数据反馈给光刻机，帮助光刻机优化不同层之间的光刻图案对齐误差，从而避免工艺中可能出现的问题。
光学关键尺寸量测设备系列		主要对集成电路前道制程中的扩散、薄膜沉积、研磨、刻蚀、光刻等工艺中的关键尺寸进行高精度和高速度的测量
3D曲面玻璃量测设备系列		主要应用于3D曲面玻璃等构件的轮廓、弧高、厚度、尺寸测量，采用光谱共焦技术，实现高精度、高速度的非接触式测量。搭载可配置的全自动测量软件工具和完整的测试及结果分析界面。

（3）良率管理软件

公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
良率管理系统		通过综合运用统计分析和人工智能技术，以及可以根据客户需求定制化的软件工作流，为客户提供包括全维度数据管理、缺陷分类和统计分析、智能根因分析、虚拟量测、交叉分析和良率预测等在内的良率管理功能
半导体缺陷自动分类系统		通过对接客户产线上的所有缺陷检测设备，将设备获取到的缺陷数据按照缺陷的尺寸、形态、位置、聚类情况、整体分布特征等进行自动分类，并且能够追踪和统计缺陷的发生频率和条件，帮助在缺陷层面管理和控制良率
光刻套刻分析反馈系统		实现对光刻机、套刻精度量测设备、晶圆翘曲量测设备、电子束关键量测设备等多种类、多品牌机型的数据进行整合分析和建模，帮助客户及时监控和优化光刻工艺的偏差，同时通过高阶模型补偿等功能来实现对光刻机光刻套刻偏移量的准确控制，有效地提升光刻机光刻工艺的良率水平

自成立至今，公司始终坚持自主研发和自主创新原则，持续提升技术创新与产品创新能力，未来将继续深耕集成电路领域，以行业前沿技术与市场需求为导向，不断丰富产品种类及拓宽产品市场覆盖广度和深度。随着公司业务不断扩大，公司产品种类持续增加。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发模式，已逐步构建起了一套集研发、生产、销售于一体的创新机制。公司研发以设备研发和相关研发测试平台为载体，协同推进公司高端半导体质量控制设备的研发及产业化进程。

（1）设备研发项目

公司设备研发项目流程可以大致分为四个阶段，概念与可行性阶段、Alpha阶段、Beta阶段和量产阶段。

（2）研发测试平台项目

研发测试平台是指除设备研发项目外开展的其他研发活动，主要包括前瞻性技术研发、设备优化研发及关键模块研发等。

2、采购模式

公司主要根据生产计划、物料清单和零部件的库存情况确定零部件的采购计划，并按照采购计划进行采购。

公司的采购流程如下：①设备生产阶段所需物料由制造中心根据生产需求制定物料清单，提交至物控部审核；②物控部结合物料清单以及零部件的库存确定物料采购清单，并提交至采购部执行，采购部负责与供应商接洽、确定采购合同细节；③原材料交付后，针对不同类型的原材料，由品质部门负责原材料的质量检测；④入库完成采购。

3、生产模式

报告期内，公司主要根据销售订单及销售预测进行生产。

公司市场部负责市场研判并接收客户需求，市场部根据客户需求内部立项后，由总经理审批，审批通过后由物控部安排采购计划并由采购部执行采购。制造中心根据物料到达时间、订单交付时间等制定生产计划和安排生产。制造中心对装配调试后的成品进行检验，检验合格后成品入库。

报告期内，公司将少量辅助性的设备配件组装、加工或清洗业务通过外协加工完成。

4、销售模式

公司主要产品为检测和量测设备，公司产品和服务主要以直销模式进行，即由公司直接将产品销售给客户。公司市场部负责市场开发、产品的销售，同时，由客户服务部负责公司产品客户支持工作。

报告期内，公司获取订单的方式主要包括与潜在客户商务谈判、招投标和委托代理商推广。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于"新一代信息技术领域"中的"半导体和集成电路"。

（1）行业的发展阶段

受国际经济变动和行业周期性等方面影响，2023年全球半导体设备销售额略有下降。根据SEMI数据统计，2023年全球半导体设备销售额为1,062.5亿美元，同比下降1.3%。但推动半导体设备需求的全球半导体产业产能扩张仍在继续，根据SEMI数据统计，全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2,960万片后，预计2024年将继续增长6.4%。中国大陆作为全球最大的半导体生产和消费市场，吸引着全球半导体产业正加速向中国大陆转移。根据SEMI报告，2023年中国大陆晶圆产能同比增长12%，并预计2024年产能增长率将提高至13%，中国大陆晶圆厂的产能增速居全球之首，带动中国大陆的半导体设备规模快速增长。

受益于国内晶圆厂的产能持续扩张，中国大陆的半导体设备行业正处于快速发展期。根据SEMI数据统计，在2023年全球半导体设备销售额同比下降1.3%的情况下，中国大陆地区半导体设备销售额同比增长29.7%，达到366.6亿美元，自2020年以来连续四年成为全球第一大半导体设备市场。

另一方面，目前全球半导体设备市场仍处于寡头垄断局面，以应用材料、阿斯麦、拉姆研究、东京电子、科磊半导体等为代表的国际知名半导体设备企业占据了全球市场的主要份额。近年来，由于全球供应链的紧张和国际贸易摩擦，国内半导体行业越来越意识到半导体设备国产化的重要性，产业链上下游的协同发展更加紧密。凭借区位、定制化服务以及供应稳定性等优势，未来国内半导体设备厂商的市场份额将有望大幅提升。

（2）基本特点

半导体设备是整个半导体产业的重要支撑，半导体产业的快速发展不断推动着半导体设备市场规模的扩大。晶圆厂的主要投资会用于购买生产各类半导体产品所需的关键设备，如光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、质量控制设备、清洗设备、化学研磨CMP设备、离子注入设备等，这些半导体设备应用在半导体制造的核心工艺中，包括光刻、刻蚀、薄膜生长、质量控制、清洗、抛光、离子注入等。半导体设备处于半导体产业链上游的关键位置，先进的半导体设备对先进制程的推进有着至关重要的作用。半导体设备种类众多，涉及技术领域广，需要长期的研发投入以实现技术突破，其先进性直接影响下游客户的产品质量和生产效率，因此在规模化量产前需经过严格的测试以及客户验证，设备的验证壁垒高。同时，为了更好匹配下游客户的工艺提升，半导体设备的技术更新和产品迭代速度需与之保持同步甚至超前。

（3）主要技术门槛

公司所处行业作为典型的技术密集型行业，涉及光学、算法、软件、机电自动化控制等多学科、多领域知识的综合运用，具有较高的技术和客户验证壁垒。因此，新进入企业通常需要经过相对较长时间的研发积累、市场培育推广、客户验证等，较难在短时间内迅速形成市场竞争力。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处的半导体检测和量测设备行业

半导体设备分类由半导体制造工艺衍生而来，从工艺角度看，主要可以分为：光刻、刻蚀、薄膜生长、质量控制、清洗、抛光、离子注入等环节。

根据检测类型的不同，应用于前道制程和先进封装的半导体质量控制根据工艺可细分为检测（Inspection）和量测（Metrology）两大环节，检测指在晶圆表面上或电路结构中，检测其是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等对芯片工艺性能具有不良影响的特征性结构缺陷；量测指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出的量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理性参数的量测。半导体质量控制设备可相应分为检测设备和量测设备。

检测和量测设备对芯片生产良率的影响至关重要。随着技术的进步发展，集成电路前道制程的步骤越来越多，工艺也更加复杂。28nm工艺节点的工艺步骤有数百道工序，由于采用多层套刻技术，14nm及以下节点工艺步骤增加至近千道工序。根据YOLE的统计，工艺节点每缩减一代，工艺中产生的致命缺陷数量会增加50%，因此每一道工序的良品率都要保持在非常高的水平才能保证最终的良品率。当工序超过500道时，只有保证每一道工序的良品率都超过99.99%，最终的良品率方可超过95%；当单道工序的良品率下降至99.98%时，最终的总良品率会下降至约90%，因此，制造过程中对工艺窗口的挑战要求几乎"零缺陷"。检测和量测环节贯穿制造全过程，是保证芯片生产良品率非常关键的环节。随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求，制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。

（2）全球半导体检测和量测设备的市场格局

根据VLSI数据统计，2023年全球半导体检测和量测设备市场规模达到128.3亿美元。全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局，主要企业包括科磊半导体、应用材料、日立等，其中科磊半导体一家独大。根据VLSI数据统计，科磊半导体在检测与量测设备的合计市场份额占比为55.8%。全球前五大公司合计市场份额占比超过了84.1%，均来自美国和日本。

根据VLSI数据统计，2023年半导体检测和量测设备市场各类设备占比如下表所示，其中，检测设备占比为67.9%，包括纳米图形晶圆缺陷检测设备、无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备等；量测设备占比为30.8%，包括关键尺寸量测设备、套刻精度量测设备、薄膜膜厚量测设备、三维形貌量测设备等，具体情况如下：

序号	设备类型	销售额（亿美元）	占全球总销售额比例
1	明场纳米图形晶圆缺陷检测设备	25.0	19.5%
2	掩膜版缺陷检测设备	18.1	14.1%
3	无图形晶圆缺陷检测设备	13.2	10.3%
4	关键尺寸量测设备	11.4	8.9%
5	暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备	10.7	8.4%
6	图形晶圆缺陷检测设备	9.8	7.7%
7	套刻精度量测设备	8.6	6.7%
8	电子束关键尺寸量测设备	8.4	6.6%
9	电子束缺陷复查设备	5.5	4.3%
10	晶圆介质薄膜量测设备	5.0	3.9%
11	电子束缺陷检测设备	4.2	3.3%
12	X光量测设备	2.9	2.3%
13	掩膜版关键尺寸量测设备	1.3	1.1%
14	三维形貌量测设备	0.7	0.6%
15	晶圆金属薄膜量测设备	0.7	0.6%
16	其他	2.7	2.1%
合计		128.3	100.0%

数据来源：VLSI

（3）中国半导体检测和量测设备市场格局

中国大陆半导体检测与量测设备的市场处于高速发展期，市场显著高于全球半导体设备和检测和量测设备市场增长。

中国大陆半导体检测与量测设备国产化率较低，市场主要由几家垄断全球市场的国外企业占据主导地位，其中科磊半导体在中国市场的占比仍然最高，领先于所有国内外检测和量测设备公司。本土企业存在较大的国产化空间，但由于国外知名企业规模大，产品线覆盖广度高，品牌认可度高，导致本土企业的推广难度较大。近年来国内企业在检测与量测领域突破较多，受益于国内半导体产业链的迅速发展，该领域国产化率有望在未来几年加速提升。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）行业技术发展情况

从技术路线原理上看，检测和量测包括光学检测技术、电子束检测技术和X光量测技术等。在相同条件下，光学技术的检测速度比电子束检测技术快，速度可以较电子束检测技术快1,000倍以上，而X光量测技术主要应用于特定金属成分测量和超薄膜测量等特定的领域，适用场景相对较窄。光学检测技术、电子束检测技术和X光量测技术的具体情况如下表所示：

技术名称	光学检测技术	电子束检测技术	X光量测技术
主要内容	基于光学原理，通过对光信号进行计算分析以获得检测结果，具有速度快、精度高，无损伤的特点	通过聚焦电子束扫描样片表面产生样品图像以获得检测结果，具有精度高、速度较慢的特点，通常用于部分线下抽样测量部分关键区域	基于X光的穿透力强及无损伤特性进行特定场景的测量
先进制程工艺应用情况	应用于28nm及以下的全部先进制程。光学检测技术因其特点，目前广泛应用于晶圆制造环节	应用于28nm及以下的全部先进制程。电子束检测技术因其具有精度高但速度慢特点，所以基于电子束检测技术的设备一部分应用于研发环节，一部分应用在部分关键区域抽检或尺寸量测等生产环节，例如纳米量级尺度缺陷的复查、部分关键区域的表面尺度量测以及部分关键区域的抽检等	应用于28nm及以下的全部先进制程，但鉴于X光具有穿透性强、无损伤特性，所以主要应用于特定的场景，如检测特定金属成分
未来发展方向	通过提高光学分辨率，并结合图像信号处理算法，进一步提高检测精度	提升检测速度，提高吞吐量，由单一电子束向多通道电子束技术发展	基于X光的穿透性特性，扩大应用的场景范围

注：根据公开信息一般将28nm作为成熟制程和先进制程的分界线

半导体质量控制设备是集成电路生产过程中核心设备之一，涉及对集成电路制造的生产过程进行全面质量控制和工艺检测，对设备的灵敏度、速度均有较高的要求。结合三类技术路线的特点，应用光学检测技术的设备可以相对较好实现有高精度和高速度的均衡，并且能够满足其他技术所不能实现的功能，如三维形貌测量、光刻套刻测量和多层膜厚测量等应用，进而使得采用光学检测技术设备占多数。根据VLSI数据统计，2023年全球半导体检测和量测设备市场中，应用光学检测技术、电子束检测技术及X光量测技术的设备市场份额占比分别为81.4%、14.2%及2.3%，应用光学检测技术的设备占比具有领先优势，电子束检测技术亦具有一定的市场份额。

（2）光学检测技术的发展趋势

目前主流半导体制程正从28nm、14nm向10nm、7nm发展，部分先进半导体制造厂商已实现5nm工艺的量产并开始3nm工艺的研发，三维FinFET晶体管、3D NAND等新技术亦逐渐成为目前行业内主流技术。随着工艺不断进步，产品制程步骤越来越多，微观结构逐渐复杂，生产成本呈指数级提升。为了获取尽量高的晶圆良品率，必须严格控制晶圆之间、同一晶圆上的工艺一致性，因此对集成电路生产过程中的质量控制需求将越来越大。未来检测和量测设备需在灵敏度、准确性、稳定性、吞吐量等指标上进一步提升，保证每道工艺均落在容许的工艺窗口内，保证整条生产线平稳连续的运行。检测和量测设备的技术的发展趋势体现在以下三个方面：

①光学检测技术分辨率提高

随着DUV、EUV光刻技术的不断发展，集成电路工艺节点不断升级，对检测技术的空间分辨精度也提出了更高要求。目前最先进的检测和量测设备所使用的光源波长已包含DUV波段，能够稳定地检测到小于14nm的晶圆缺陷，并且能够实现0.003nm的膜厚测量重复性。检测系统光源波长下限进一步减小和波长范围进一步拓宽是光学检测技术发展的重要趋势之一。此外，提高光学系统的数值孔径也是提升光学分辨率的另一个突破方向，以图形晶圆缺陷检测设备为例，光学系统的最大数值孔径已达到0.95，探测器每个像元对应的晶圆表面的物方平面尺寸最小已小于30nm。未来，为满足更小关键尺寸的晶圆上的缺陷检测，必须使用更短波长的光源，以及使用更大数值孔径的光学系统，才能进一步提高光学分辨率。

②大数据检测算法和软件重要性凸显

达到或接近光学系统极限分辨率的情况下，最新的光学检测技术已不再简单地依靠解析晶圆的图像来捕捉其缺陷，而需结合深度的图像信号处理软件和算法，在有限的信噪比图像中寻找微弱的异常信号。晶圆检测和量测的算法专业性很强，检测和量测设备对于检测速度和精度要求非常高，且设备从研发到产业化的周期较长。因此，目前市场上没有可以直接使用的软件。业内企业均在自己的检测和量测设备上自行研制开发算法和软件，未来对检测和量测设备相关算法软件的要求会越来越高。

③设备检测速度和吞吐量的提升

半导体质量控制设备是晶圆厂的主要投资支出之一，设备的性价比是其选购时的重要考虑因素。质量控制设备检测速度和吞吐量的提升将有效降低集成电路制造厂商的平均晶圆检测成本，从而实现降本增效。因此，检测速度和吞吐量更高的检测和量测设备可帮助下游客户更好地控制企业成本，提高良品率。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,428,017,518.02	1,660,586,174.02	1,652,375,488.59	106.43	1,089,784,331.01	1,082,757,070.52
归属于上市公司股东的净资产	2,410,956,558.63	569,528,349.87	568,922,472.03	323.33	555,142,218.41	554,763,759.27
营业收入	890,900,112.98	509,235,313.90	509,235,313.90	74.95	360,553,447.47	360,553,447.47
归属于上市公司股东的净利润	140,344,610.24	11,970,878.31	11,743,459.61	1,072.38	53,804,317.98	53,425,858.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,692,952.85	-87,623,918.56	-87,851,337.26	不适用	3,858,547.95	3,480,088.81
经营活动产生的现金流量净额	-52,037,407.97	67,014,316.52	67,014,316.52	不适用	-99,894,637.35	-99,894,637.35
加权平均净资产收益率（%）	8.60	2.13	2.09	增加6.47个百分点	10.23	10.17
基本每股收益（元/股）	0.49	0.05	0.05	880.00	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.05	0.05	880.00	0.22	0.22
研发投入占营业收入的比例（%）	25.62	40.40	40.40	减少14.78个百分点	26.36	26.36

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	161,763,960.23	203,712,977.02	222,339,051.24	303,084,124.49
归属于上市公司股东的净利润	31,367,069.83	14,572,036.98	33,183,546.36	61,221,957.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-790,455.70	3,143,872.18	16,392,153.74	12,947,382.63
经营活动产生的现金流量净额	39,324,282.92	12,550,572.26	-35,054,987.74	-68,857,275.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

项目	数量
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,711
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
苏州翌流明光电科技有限公司	0	37,800,963	11.81	37,800,963	37,800,963	无	0	境内非国有法人
国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	0	36,465,943	11.40	36,465,943	36,465,943	无	0	其他
深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）	0	18,855,937	5.89	18,855,937	18,855,937	无	0	其他
哈承姝	0	16,643,853	5.20	16,643,853	16,643,853	无	0	境外自然人
北京芯动能投资基金（有限合伙）	0	15,382,835	4.81	15,382,835	15,382,835	无	0	其他
深圳市岭南晟业有限公司	0	14,564,419	4.55	14,564,419	14,564,419	无	0	境内非国有法人
深圳市前海博林股权投资基金有限公司	0	13,334,490	4.17	13,334,490	13,334,490	无	0	境内非国有法人
中国科学院微电子研究所	0	11,604,106	3.63	11,604,106	11,604,106	无	0	国有法人
上海上创新微投资管理有限公司－上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	10,226,754	3.20	10,226,754	10,226,754	无	0	其他
深圳市创新投资集团有限公司	0	9,789,934	3.06	9,789,934	9,789,934	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	哈承姝持有小纳光1.71%的出资额和苏州翌流明31.00%的股份，其中，苏州翌流明担任小纳光的执行事务合伙人，并持有小纳光1.47%的出资额；哈承姝和苏州翌流明分别持有横琴承心99.00%和1%的出资额，横琴承心持有小纳光51.50%的出资额；苏州翌流明、小纳光和哈承姝之间构成一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

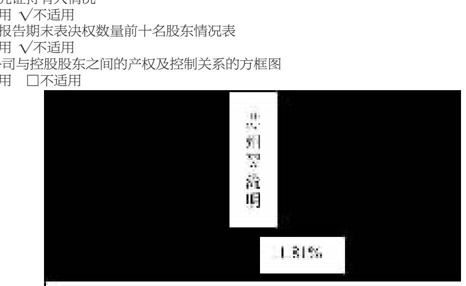
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

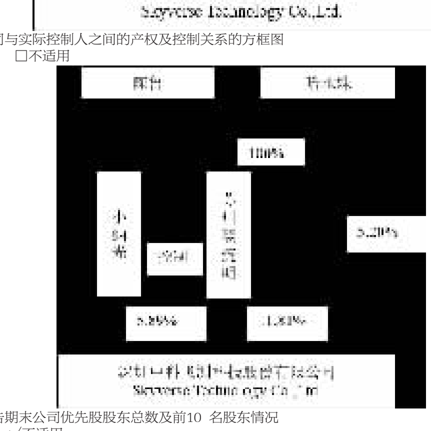
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入89,090.01万元，较上年同期增长74.95%；归属于上市公司股东的净利润为14,034.46万元，较上年同期增长1,072.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,169.30万元，较上年同期增长11,931.69万元，实现扭亏为盈。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

一、聚焦主业，持续突破创新提升竞争力

公司专注于高端半导体质量控制领域，为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。在设备产品方面，公司通过在光学检测技术、大数据检测算法和自动化软件领域的自主研发和不断创新，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平，形成了集成电路制造过程中所有关键工艺环节所需的主要种类设备产品组合，使得公司能够为不同类型的集成电路客户提供全面覆盖的检测和量测设备供应保障，支持客户的量产工艺需求和未来工艺研发需求；在智能软件产品方面，公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果。

2023年度，公司实现营业收入89,090.01万元，同比增长74.95%，主要系以下多种因素的积极影响：一方面，得益于公司在关键核心技术、产业化推进和迭代升级各系列产品的过程中取得的重要成果，公司产品种类日趋丰富，市场竞争力持续增强，市场地位进一步巩固；另一方面，国内半导体检测与量测设备市场呈现高速发展，下游客户设备国产化需求迫切，公司凭借较强的技术创新能力、优异的产品品质以及出色的售后服务等积极因素，品牌认可度不断提升，客户群体覆盖度进一步扩大，客户订单量持续增长。同时，随着经营规模的快速增长，规模效应逐步凸显，公司在保持较高的研发投入水平情况下，盈利水平显著提升，归属于母公司所有者的净利润同比增长1,072.38%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加11,931.69万元，实现扭亏为盈。

2024年度，公司将继续专注于高端半导体质量控制领域，进一步提升经营管理能力及综合实力，实现长期、稳定和可持续的发展。具体包括以下方面：

1、持续高水平研发投入，稳步推进各系列设备产业化进程

核心技术实力作为公司市场竞争力及行业地位的重要体现，公司一直将研发能力的提升作为自身发展的重要战略。

2024年度，公司将继续以行业前沿技术与市场客户需求为导向，持续高水平研发投入，不断提升研发实力，提高产品性能、丰富产品类型及拓宽产品应用领域。其中，公司2024年度将重点开展明场纳米图形晶圆缺陷检测设备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备及光学关键尺寸量测设备等相关产品的研发，稳步推进各系列设备产业化进程。公司将继续坚持以技术为核心竞争力，持续吸收和培养专业人才，进一步强化技术研发实力，满足下游客户不断提升的工艺需求，进一步提高公司的品牌认可度，缩小与国际龙头企业的差距。

2、持续优化供应链体系，保障生产经营安全稳定

长期以来，公司重视半导体设备零部件的国产化替代，并积极与相关领域供应商建立良好和稳定的合作关系。

2024年度，公司将持续关注国内供应商的发展，并共同推动产业链上下游的协同发展。同时，公司将持续优化采购供应链，提升原材料采购质量，优化采购成本，公司对供应商实施动态管理，定期对供应商历史采购价格、供货周期、产品质量、技术发展、合作服务等方面进行评比，并由采购部门根据物料的采购情况、市场行情，和供应商进行商务谈判或引入新的供应商，争取更具优势的价格及商务条款。

3、加大市场开发力度，进一步提升市场占有率

公司一直以客户需求为中心，不断满足集成电路前道制程、先进封装等企业对质量控制设备的高技术水平和高性能的需求。凭借较强的技术创新能力、优异的产品品质以及出色的售后服务，公司积累了优质的客户资源和良好的品牌知名度，并与客户建立了良好合作关系，市场占有率稳步提升。

2024年度，公司依托日趋多元的产品结构及长期积累的市场口碑，积极推进新产品的客户验证及市场推广，充分挖掘国内外潜在客户需求，进一步提升公司市场占有率，实现长期、稳定和可持续的发展。

4、强化人才体系建设，保障公司持续健康发展

公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，人才是公司长期稳定发展的根基，公司历来重视人才培养和储备，促进员工与企业共同成长。

2024年度，公司将持续构筑跨专业、多层次的人才梯队，完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，发挥员工的创造力和潜在动力，满足公司快速发展对人才的需求。同时，公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划。2024年度，公司将根据实际需求规划全年培训次数不少于50次，覆盖新员工入职、专业技能、通用能力、管理能力等方面的专题培训，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工个性化的职业生涯规划。

为进一步促进公司核心人才队伍的建设和稳定，公司已制定并实施《2024年限制性股票激励计划》。通过实施股权激励，公司建立健全激励约束长期机制，充分调动公司员工的积极性，从而有利于兼顾员工与公司长远利益，为公司良性发展夯实基础。

5、规范募集资金使用，稳步推进募投项目建设

2023年5月，公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金净额16.98亿元将全部用于公司主营业务相关科技创新领域，截至目前公司各募投项目正在有序建设中。

2024年度，公司将严格遵守募集资金管理规定，规范使用募集资金，切实保证募投项目顺利实施，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力。随着募投项目的顺利实施，公司研发及生产实力将得到显著提升。

二、优化运营管理，提高经营效率

随着公司规模的扩大，2024年度，公司将着重提升综合运营管理能力，继续致力于实现高质量的运营管理和可持续增长。

公司将持续重视应收账款管理工作，设置合理的信用政策，加强账期管理力度，监控好账款回收情况，提高应收账款周转率，以进一步持续改善经营性现金流。同时，公司还将继续加强存货管理，结合市场情况，设置合理的库存警戒线，提高存货周转率。同时，公司将进一步落实预算管理工作，准确的控制好各项成本与费用，做好成本优化和费用管理工作，推动公司的各项支出更趋合理，推进降本增效，以期提高盈利水平。

此外，公司还将持续注重财务数据分析工作，提升财务管理信息化水平，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

三、重视提高股东回报，分享公司长期发展红利

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值，增强投资者信心，推动公司股价与长期发展价值向匹配。

2024年度，公司将结合所处发展阶段、业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势等方面，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，提升股东回报水平，落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准，拟每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利4,480万元（含税），本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的31.92%。

四、持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：

1、进一步建立健全内控体系，加强内部审计和风险控制

随着公司及经营规模的快速增长，2024年度，公司将进一步加强内控体系建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。公司将结合现代化企业治理机制及各业务部门运作规范，着眼于管理创新，进一步完善适合本公司的内部控制管理体系，明确各部门人员的职责和权限，建立彼此协同、彼此约束的内控制度。同时，公司将持续完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

2、深化公司治理，强化"关键少数"主体责任

2024年度，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等"关键少数"合规意识，切实推动公司高质量发展。

3、加强董事会建设，安排董监高培训

公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定加强董事会建设，组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律法规，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。本年度，公司将安排董监高参与不少于4次的上述培训活动。

五、高质量信息披露，充分传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2024年度，公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给市场参与者们。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。公司2024年度将开展不低于50次包括电话会议或线下面对面的投资者接待活动。

2024年度，公司将继续保持与投资者积极的线上交流，每年通过"上证路演中心"、"进门财经"等平台举办不少于6次投资者线上交流会，包括公司董事长、总经理在内的全体高管将继续参加业绩说明会，与投资者就公司经营情况、发展规划等进行沟通。公司计划于2023年年度报告公告后，举行2023年度业绩说明会就投资者关心的问题进行交流。

2024年度，公司将邀请投资机构、分析师及有兴趣的投资者，参与公司投资者接待日活动，现场参观公司主要经营场所，更加直观、贴近感受公司经营情况及企业文化。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估并完善"提质增效重回报"行动方案的具体举措。一方面，公司将继续强化规范运作理念和法律法规的敬畏意识，严格遵守证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，做到信息披露真实、准确、完整，公平对待所有投资者。另一方面，公司将切实履行上市公司的责任和义务，专注主业，以助力我国集成电路产业自立自强发展为己任，稳步提升公司经营规模、盈利能力，不断增强公司核心竞争力，以优良的业绩切实回报投资者，维护公司市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2024-021

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于2023年2月21日核发《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票。公司于2023年5月19日首次公开发行的股份数量为8,000.00万股，发行价格为每股23.60元，募集资金总额为人民币188,800.00万元，扣除发行费用人民币18,961.34万元后，募集资金净额为人民币169,838.66万元。已于2023年5月16日通过国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）汇入公司银行账户。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2023]32719号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入和扣除银行手续费的净余额）余额为10,614.42万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	169,838.66
减：投入募集资金项目金额	47,418.59
减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额	20,500.00
加：理财收益	334.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	760.32
截至2023年12月31日募集资金余额	103,014.42
其中：期末未到期理财产品	92,400.00
实际募集资金专户余额	10,614.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。2023年5月及6月，公司、保荐人国泰君安、存放募集资金的中国银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签订募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储。

截至2023年12月31日，本公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金，上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

存放银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	769277071129	268.62
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	15201412318833	723.03
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	44250100000800005439	108.44
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	337060100100544110	4,898.97
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	8110301013000682608	396.52
招商银行股份有限公司深圳红山支行	755942306110108	1,842.88
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929100801232	41.97
上海银行深圳前海分行	03005344408	15.47
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000445229	5.27
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	754977254881	0.00
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	8110301012100684395	1,893.22
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	745877261923	420.04
合计		10,614.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况请详见"附表1：2023年度募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年6月14日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币13,422.23万元置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对上述事项出具了核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2023]34265号）。

截至2023年12月31日，公司涉及置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金应置换13,422.23万元，已经全部置换完成。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

（三）使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月26日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人国泰君安对上述事项出具了核查意见。

截至2023年12月31日，公司涉及使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为9,871.99万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年6月14日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过自公司本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了核查意见。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为92,400万元。具体情况如下：

单位：万元

金融机构	理财类型	起息日	到期日	金额	利率
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	结构性存款	2023/7/18	2024/1/16	2,000.00	浮动
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	可转让大额存单	2023/7/14	2026/7/14	13,000.00	2.90%
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	结构性存款	2023/7/15	2024/1/11	15,000.00	浮动
上海银行股份有限公司深圳前海分行	结构性存款	2023/7/20	2024/1/17	2,000.00	浮动
工商银行股份有限公司深圳大浪支行	定期存款	2023/7/31	2024/1/31	13,900.00	1.70%
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	结构性存款	2023/8/7	2024/2/3	2,600.00	浮动
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	结构性存款	2023/8/7	2024/2/2	2,400.00	浮动
上海银行股份有限公司深圳前海分行	结构性存款	2023/9/21	2024/3/30	3,000.00	浮动
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	结构性存款	2023/10/21	2024/1/19	5,000.00	浮动
招商银行股份有限公司深圳红山支行	结构性存款	2023/10/23	2024/1/23	3,000.00	浮动
建设银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	2023/11/10	2024/1/11	10,000.00	浮动
建设银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	2023/11/10	2024/2/8	5,000.00	浮动
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	结构性存款	2023/11/23	2024/6/4	2,400.00	浮动
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	结构性存款	2023/11/23	2024/6/3	2,600.00	浮动
招商银行股份有限公司深圳红山支行	结构性存款	2023/12/20	2024/1/22	2,000.00	浮动
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款	2023/12/28	2024/1/29	4,000.00	浮动
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	结构性存款	2023/12/28	2024/1/29	3,500.00	浮动
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	结构性存款	2023/12/29	2024/2/2	1,000.00	浮动

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年6月14日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，2023年7月3日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币20,500.00万元的超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额69,838.66万元的比例为29.35%。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了无异议的核查意见。

截至2023年12月31日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款20,500.00万元，已经全部完成。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年12月15日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金30,877.70万元增加"高端半导体质量控制设备产业化项目"投资规模，本次增加投资规模后项目总投资额由30,895.84万元调增为61,773.54万元，募集资金投入金额由30,800.00万元增加至61,677.70万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了无异议的核查意见。2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》。

截至2023年12月31日，本公司不涉及使用超募资金用于在建项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年6月14日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金10,600万元向全资子公司广州中科飞测科技有限公司（以下简称"广州中科飞测"）实缴注册资本并提供20,200万元借款以实施"高端半导体质量控制设备产业化项目"。根据项目实施需要逐步拨付（借款不计息），借款期限为实际借款之日起3年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还。到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了无异议的审查意见。

截至2023年12月31日，公司使用募集资金向广州中科飞测实缴注册资本为10,600.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年12月15日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金30,877.70万元增加"高端半导体质量控制设备产业化项目"投资规模，本次增加投资规模后项目总投资额由30,895.84万元调增为61,773.54万元，募集资金投入金额由30,800.00万元增加至61,677.70万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了无异议的核查意见。截至2023年12月31日，该议案尚未履行完股东大会审批程序，直至2024年1月4日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。公司本次增加募投项目投资规模计划以向募投项目实施主体广州中科飞测借款方式实施，根据项目实施需要逐步支付，借款不计息，借款期限为实际借款之日起3年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金存放及实际使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科飞测《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：中科飞测2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对中科飞测2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1

深圳中科飞测科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：深圳中科飞测科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元

募集资金净额		169,838.66			本年度投入募集资金总额							67,918.59
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额							67,918.59
变更用途的募集资金总额比例（%）		–										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端半导体质量控制设备产业化项目	注	30,800.00	30,800.00	30,800.00	5,287.85	5,287.85	-25,512.15	17.17	不适用	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	12,539.57	12,539.57	-1,660.43	88.31	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	29,591.17	29,591.17	-25,408.83	53.80	不适用	不适用	不适用	否
超额募集资金净额	注	69,838.66	69,838.66	69,838.66	20,500.00	20,500.00	-49,338.66	29.35	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	169,838.66	169,838.66	169,838.66	67,918.59	67,918.59	-101,920.07	39.99	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告"三、2023年年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"相关内容。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、2023年年度募集资金的实际使用情况"之"（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"相关内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告"三、2023年年度募集资金的实际使用情况"之"（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"相关内容。											
募集资金结余的金额及形成原因	无。											
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告"三、2023年年度募集资金的实际使用情况"之"（九）募集资金使用的其他情况"相关内容。											

注：2023年12月15日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金30,877.70万元增加"高端半导体质量控制设备产业化项目"投资规模，本次增加投资规模后项目总投资额由30,895.84万元调增为61,773.54万元，募集资金投入金额由30,800.00万元增加至61,677.70万元。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了无异议的核查意见。截至2023年12月31日，该议案尚未履行完股东大会审批程序，直至2024年1月4日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。公司本次增加募投项目投资规模计划以向募投项目实施主体广州中科飞测借款方式实施，根据项目实施需要逐步支付，借款不计息，借款期限为实际借款之日起3年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2024-022

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

● 本次会计估计变更自2023年12月31日起执行。

一、会计估计变更概述

公司产品结构日趋丰富，各系列新产品不断推向市场，不同产品系列及市场推广阶段的产品历史上实际发生的产品质量保证费用存在一定差异。为了更加准确地反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中产品质量保证金计提的会计估计与实际情况更加接近，根据公司产品质量保证费用实际发生的情况，拟对产品质量保证计提比例进行会计估计变更。

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更的内容

1、变更前公司采用的会计估计

公司根据历年实际发生产品质量保证费用的相关数据，各期末针对尚处于质保期内的设备，均按照该设备确认收入的3%计提产品质量保证形成的预计负债。

2、变更后公司采用的会计估计

公司根据历年实际发生产品质量保证费用的相关数据，各期末针对尚处于质保期内的产品，均按照不同产品类型履行相关现时义务所需支出的最佳估计数计提产品质量保证形成的预计负债。

（二）会计估计变更日期

本次会计估计变更自2023年12月31日起执行。

（三）会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第13号——或有事项》第十二条，企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司产品结构日趋丰富，各系列新产品不断推向市场，不同产品系列及市场推广阶段的产品历史上实际发生的产品质量保证费用存在一定差异。为了更加准确地反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中产品质量保证金计提的会计估计与实际情况更加接近，根据公司产品质量保证费用实际发生的情况，调整产品质量保证金的计提比例。

（四）会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更后，增加2023年度销售费用及2023年末预计负债1,225.99万元，减少2023年度归属于上市公司股东的净利润1,225.99万元。

三、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计估计变更相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）会计师事务所意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》之《第十六号科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中科飞测的会计估计变更情况。

四、审计委员会审议情况

审计委员会认为本次会计估计变更符合公司实际经营需要，具有合理性和合规性。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意本次会计估计的变更。

（下转B246版）